

株式会社リョーサン

2016年度 決算説明会

2017年5月25日

代表取締役社長執行役員

三松 直人

2016年度 業績結果

2017年度 通期 業績計画

第9次中期経営計画の取り組み状況と計画

資料取扱い上のご注意

このプレゼンテーションで述べられている業績計画等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりです。

- ・主要市場(日本、アジア等)の経済状況、消費動向及び製品需給の急激な変動
- ・ドル等の対円為替相場の大幅な変動
- ・資本市場における相場の大幅な変動等

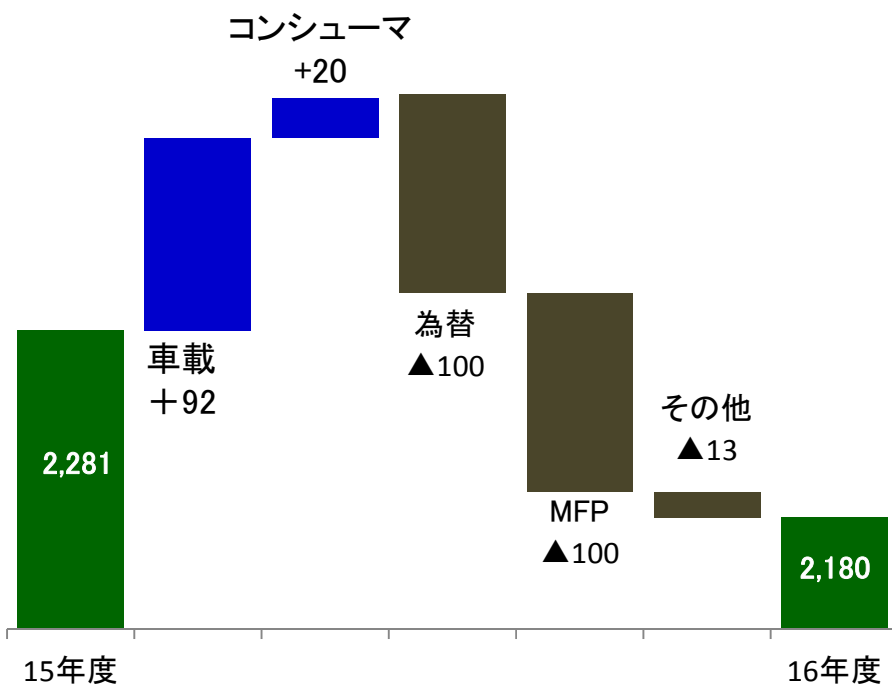
- 2016年度(以下、16年度)連結業績は、車載・コンシューマー分野等で明るい兆し出てきたものの、円高・15年度大口案件の終息等の影響大きく、前年同期比で減収減益。
- 当期純利益を除き、見直し後期初計画はクリア。

| (単位:億円) | 15年度 | | 16年度 | | | | | | |
|-------------------|--------|------|-------|-------|--------|------|--------|--------------|------------|
| | 金額 | % | 上期 | 下期 | 金額 | % | 前年度比 | 見直し後 期初計画 | 見直し 計画比 |
| 売上高 | 2,281 | | 1,018 | 1,161 | 2,180 | | △4.4% | 2,150 | +1.4% |
| 売上総利益 | 193 | 8.5% | 85 | 97 | 183 | 8.4% | △5.1% | 179 | +2.4% |
| 販売管理費 | 137 | 6.0% | 67 | 69 | 136 | 6.3% | △0.8% | 135 | +1.2% |
| 営業利益 | 55 | 2.4% | 18 | 27 | 46 | 2.1% | △15.9% | 44 | +5.9% |
| 当期純利益 | 36 | 1.6% | 17 | 16 | 33 | 1.5% | △8.3% | 36 | △6.5% |
| 1株当たり当期 純利益(円) | 119.77 | | 58.13 | 58.41 | 116.54 | | △2.7% | 123.78 | △5.8% |

- 売上高は、為替・MFPビジネス終息によるマイナス効果を車載・コンシューマー関連ビジネスで打ち返し▲100億円。
- 経常利益は粗利益ベースでは増益を確保したものの、為替・人件費等増加の結果、前年度比減益8億円。

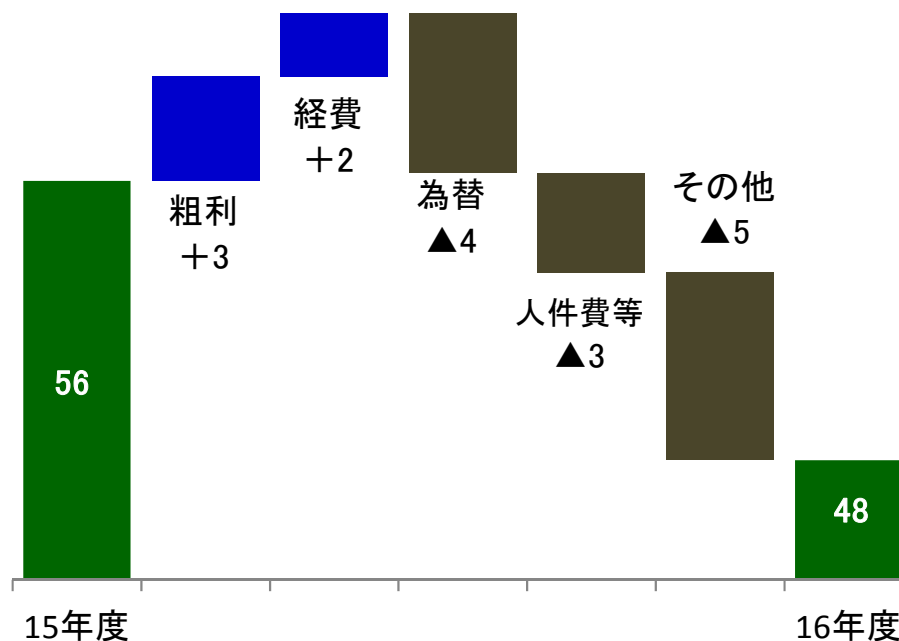
売上高

(単位:億円)



経常利益

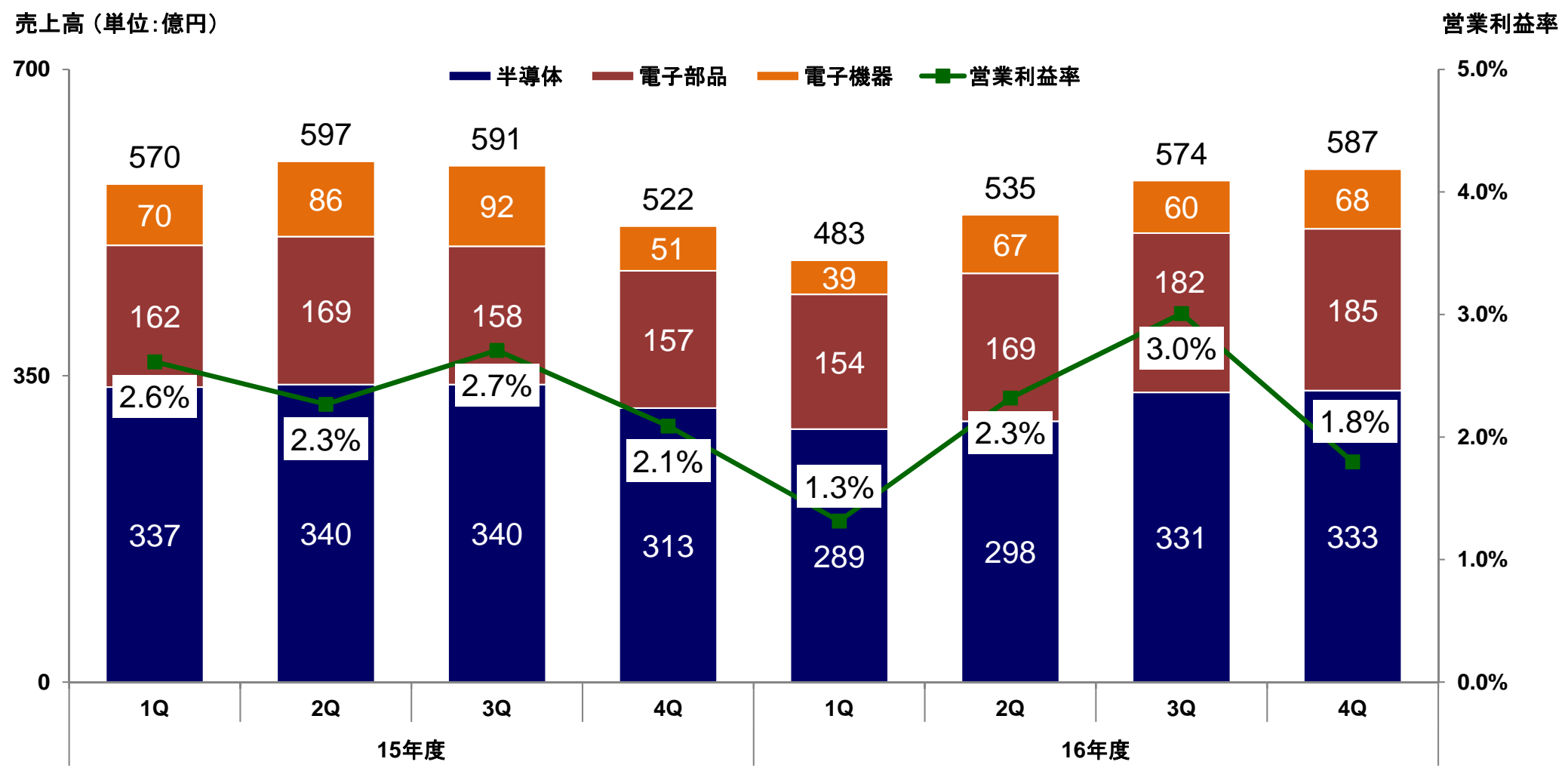
(単位:億円)



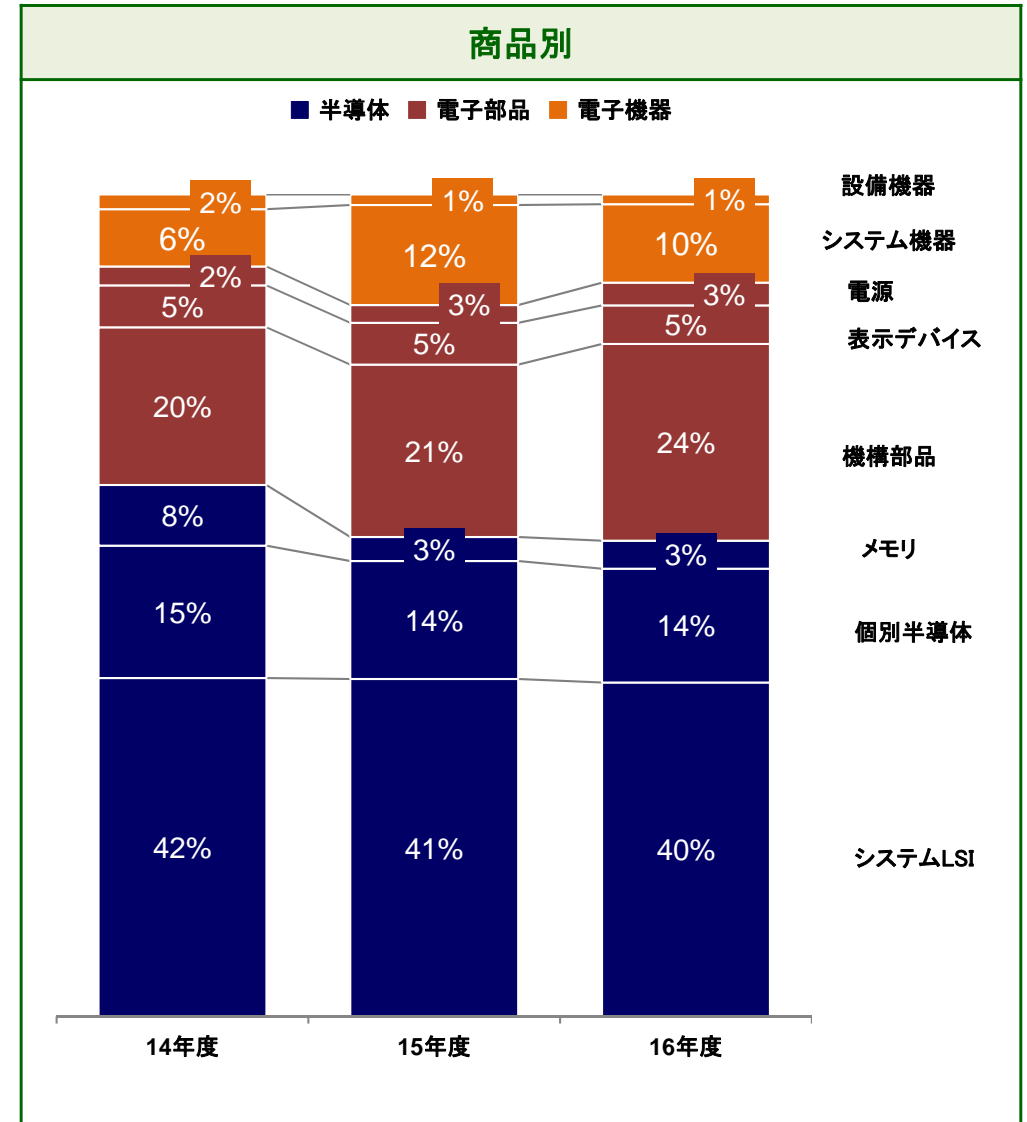
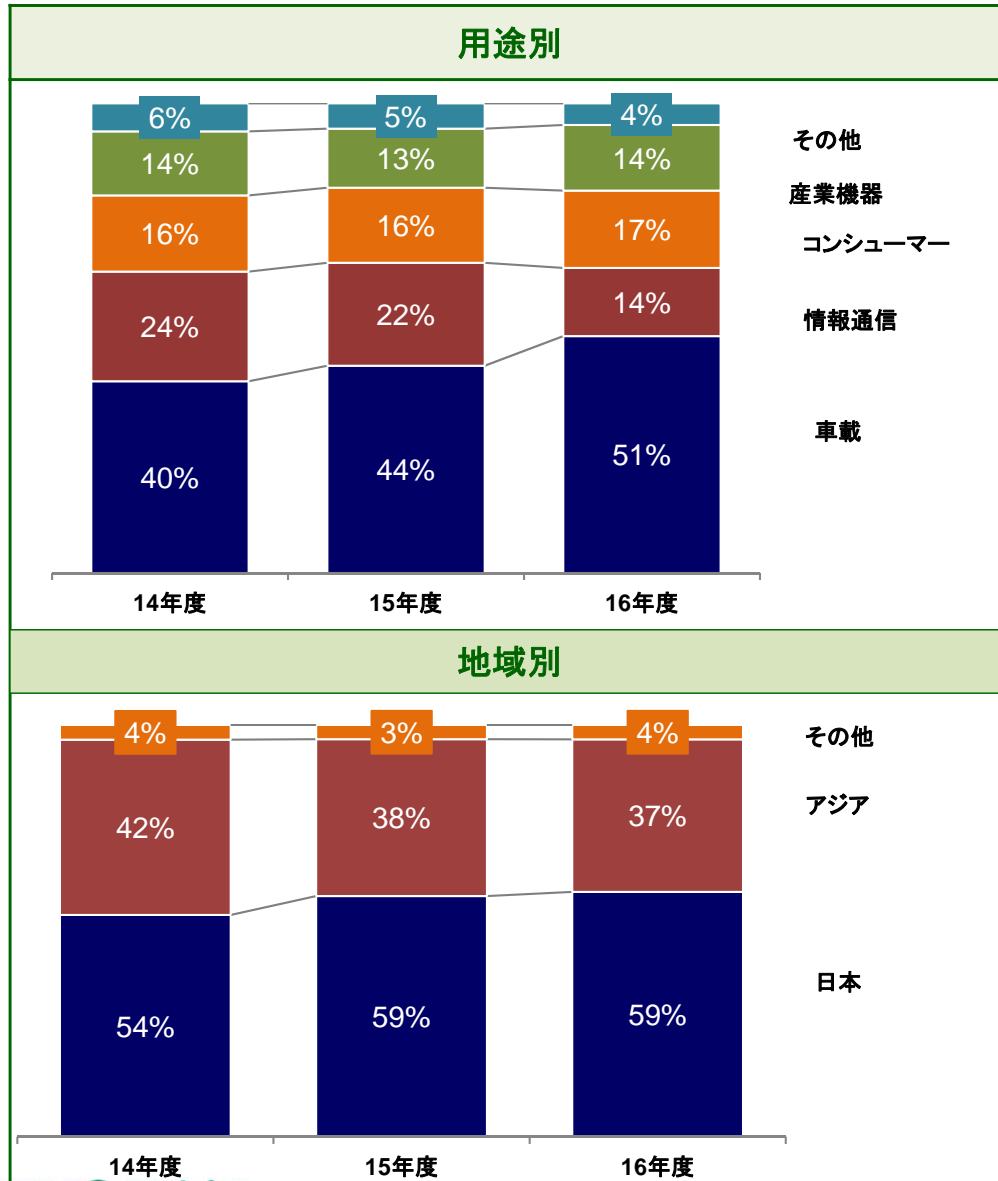
- 半導体事業は円高、情報通信端末向けビジネス終息、カーナビ・カーオーディオやデジタルカメラの販売不振の影響等を受け、減収減益。
- 電子部品事業も円高影響を受けたが、車載・コンシューマービジネスが堅調に推移。
- 電子機器事業はMFP向けビジネス終息によるもの。

| (単位:億円) | | 15年度 | | 16年度 | | | | |
|---------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------|
| | | 実績 | % | 上期 | 下期 | 実績 | % | 前年比 |
| 半導体事業 | 売上高 | 1,331 | | 588 | 664 | 1,253 | | △5.9% |
| | 営業利益 | 29.5 | 2.2% | 10.8 | 14.0 | 24.8 | 2.0% | △15.8% |
| 電子部品事業 | 売上高 | 649 | | 323 | 368 | 691 | | +6.5% |
| | 営業利益 | 15.4 | 2.4% | 8.1 | 11.2 | 19.4 | 2.8% | +26.4% |
| 電子機器事業 | 売上高 | 301 | | 106 | 128 | 235 | | △21.9% |
| | 営業利益 | 15.0 | 5.0% | 3.1 | 3.7 | 6.9 | 3.0% | △53.9% |
| 営業利益調整額 | | △4.6 | | △3.4 | △1.2 | △4.6 | | |
| 計 | 売上高 | 2,281 | | 1,018 | 1,161 | 2,180 | | △4.4% |
| | 営業利益 | 55.3 | 2.4% | 18.7 | 27.8 | 46.5 | 2.1% | △15.9% |

- 電子部品事業が車載向けビジネスで堅調を維持し、電子機器事業も車載向け大型案件を獲得したことにより、16年度第1四半期を底とする売上改善トレンドは継続。
- 収益的には期末の価格引下げ圧力等有り反転、減益。



- 商品別構成比に大きな変化はない。用途別では、情報通信向け売上高構成比が縮小する一方で、車載向け売上高構成比が高まる。



- 配当金の支払い48億円、自己株式取得44億円等により、現預金及び有価証券が120億円減少、純資産を削減。
- 外資系半導体事業伸張に伴い営業活動によるキャッシュ・フロー負担増加。

(単位:億円)

| ■ 連結貸借対照表 | 15年3月末 | 16年3月末 | 17年3月末 | 比較増減 |
|-----------|--------|--------|--------|------|
| 総資産 | 1,688 | 1,570 | 1,616 | +46 |
| 流動資産 | 1,492 | 1,391 | 1,428 | +36 |
| 固定資産 | 195 | 178 | 187 | +9 |
| 負債 | 470 | 416 | 521 | +104 |
| 純資産 | 1,218 | 1,153 | 1,095 | △58 |
| 自己資本比率 | 72.2% | 73.5% | 67.8% | △5.7 |

(単位:億円)

| ■ 連結キャッシュ・フロー計算書 | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 比較増減 |
|------------------|------|------|------|------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116 | 47 | △18 | △65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9 | 5 | △8 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △75 | △95 | △92 | +3 |
| 現金及び現金同等物残高 | 559 | 507 | 386 | △120 |

2016年度 業績結果

2017年度 通期 業績計画

第9次中期経営計画の取り組み状況と計画

連結計画の概要

- 引き続き車載・FA機器・コンシューマーは堅調に推移するものと想定。今年度比増収・増益を計画(為替計画レート1ドル105円)。
- 売上増加に対して販売管理費の増加抑制を抑えたことから営業利益等の収益性が改善。自己株買いの進捗もあり1株当たりの収益も増加の見込み。

| (単位:億円) | 16年度 | | 17年度 | | | | | |
|---------------|--------|------|-------|-------|--------|------|--------|-------|
| | 通期 | % | 上期 | 下期 | 通期 | % | 前年度比 | 中計目標 |
| 売上高 | 2,180 | | 1,120 | 1,180 | 2,300 | | +5.5% | 2,700 |
| 売上総利益 | 183 | 8.4% | 94 | 98 | 192 | 8.3% | +4.8% | 235 |
| 販売管理費 | 136 | 6.3% | 69 | 67 | 136 | 5.9% | △0.5% | 140 |
| 営業利益 | 46 | 2.1% | 25 | 31 | 56 | 2.4% | +20.2% | 95 |
| 当期純利益 | 33 | 1.5% | 18 | 22 | 40 | 1.7% | +18.8% | 60 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 116.54 | | 64.06 | 78.30 | 142.36 | | +22.2% | |

- 一部を除き、全セグメントにおいて前期比増収増益。
- 半導体事業は車載・FA機器向けビジネスの好調による。電子部品事業は車載・コンシューマー向けビジネスが牽引。電子機器事業は車載向けビジネスの拡大や大型設備投資案件の寄与が見込まれることによる。

| (単位: 億円) | | 16年度 | | 17年度 | | | | | |
|----------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------|-------|
| | | 通期 | % | 上期 | 下期 | 通期計画 | % | 前年比 | 中計目標 |
| 半導体事業 | 売上高 | 1,253 | | 645 | 665 | 1,310 | | +4.5% | 1,500 |
| | 営業利益 | 24.8 | 2.0% | 15.0 | 18.5 | 33.5 | 2.6% | +34.6% | 51.0 |
| 電子部品事業 | 売上高 | 691 | | 340 | 350 | 690 | | △0.2% | 700 |
| | 営業利益 | 19.4 | 2.8% | 9.5 | 10.5 | 20.0 | 2.9% | +2.8% | 20.3 |
| 電子機器事業 | 売上高 | 235 | | 135 | 165 | 300 | | +27.5% | 300 |
| | 営業利益 | 6.9 | 3.0% | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 2.5% | +8.0% | 14.7 |
| 営業利益調整額 | | △4.6 | | △2.5 | △2.5 | △5.0 | | | |
| 計 | 売上高 | 2,180 | | 1,120 | 1,180 | 2,300 | | +5.5% | 2,700 |
| | 営業利益 | 46.5 | 2.1% | 25.0 | 31.0 | 56.0 | 2.4% | +20.2% | 95.0 |

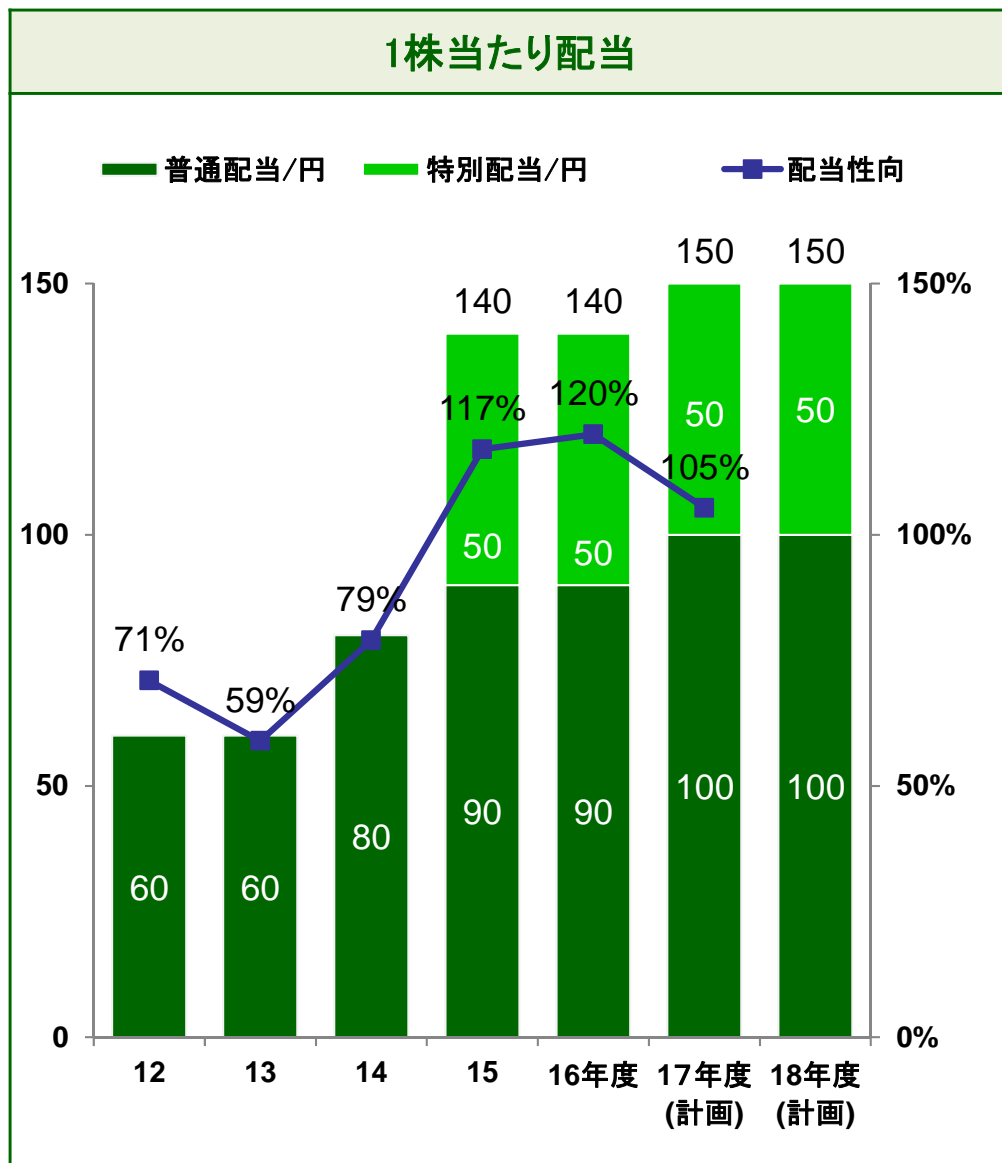
第9次中期経営計画における追加的な資本効率化施策(第二弾)

| | 現状 | 本件後 |
|----------|--|---|
| 1株当たり配当金 | 17年度 年間150円以上 (普通配当100円) (特別配当 50円以上) | 17~18年度 年間150円以上 (普通配当100円) (特別配当 50円以上) |
| 自己株式取得 | 17年度 年間300万株 | 17~18年度 年間450万株 |
| 自己株式消却 | 計画なし | 17年度 300万株 |

【背景】

- 第9次中期経営計画において、「成長路線の再構築」に加えて、「資本効率の向上」を最重要課題と位置付け。過去2年間の総還元平均は245%。
- 16年7月に配当金増額(16年度140円以上・17年度150円以上)自己株式取得300万株/年を骨子とする追加的な資本効率化施策を公表し、対応中。
- 今般は、16年度の自己株式取得が当初計画を下回ったこと(1.3百万株)、足下の業績は改善傾向にあるもののROE5%目標実現に向けて、更に踏み込んだ取組みが必要と判断。資本効率化施策(第二弾)を実施し、目標達成を目指す。
- 本件後も「成長路線の再構築」を通じた収益性の改善と「資本効率の向上」を両輪とする経営スタンスは不変。

- 増配方針、普通配当金100円、特別配当金50円以上を計画。
- 自己株式の取得は、期間17年5月から18年5月、上限450万株。



自己株式の取得

| 期間 | 取得株数 (万株) | 金額 (億円) |
|------------------|-----------|---------|
| 11年8～11月 | 100 | 17 |
| 13年2月 | 100 | 19 |
| 13年5～6月 | 100 | 18 |
| 15年2～3月 | 45 | 13 |
| 15年10月 | 23 | 6 |
| 15年11月～16年2月 | 132 | 40 |
| 16年7月～17年3月 | 137 | 44 |
| 17年5月～18年5月 (計画) | 450 | 200 |
| 18年5月～19年5月 (計画) | 450 | - |

2016年度 業績結果

2017年度通期 業績計画

第9次中期経営計画の取り組み状況と計画

- 足元の計画進捗状況を勘案、ROE5%目標達成時期を1年後倒し(FY18)する。
- 達成に向けて既存施策の強化に加えて、新規追加施策を手当て(FY17/18)。
- 第10次中期経営計画は予定通り策定(FY18から3年間)。ROE8%達成を目指す。

基本姿勢

事業構造の変化に対応した「ビジネスモデルの転換」と
持続可能な「自律的成長」の追求

取り組みの概要

成長路線の
再構築



継続

新たなビジネスモデルの創出
(システムソリューション力の強化)

継続

マルチベンダー化の更なる推進
(既存ビジネスにおける新たなサプライヤーおよび新規商材の拡充)

継続

グローバル対応強化による海外ビジネスの拡大
(グローバルディストリビューターを目指す)

資本効率の
向上



強化

成長に向けた積極的な投資

強化

自己株式の取得

追加

経費削減の強化

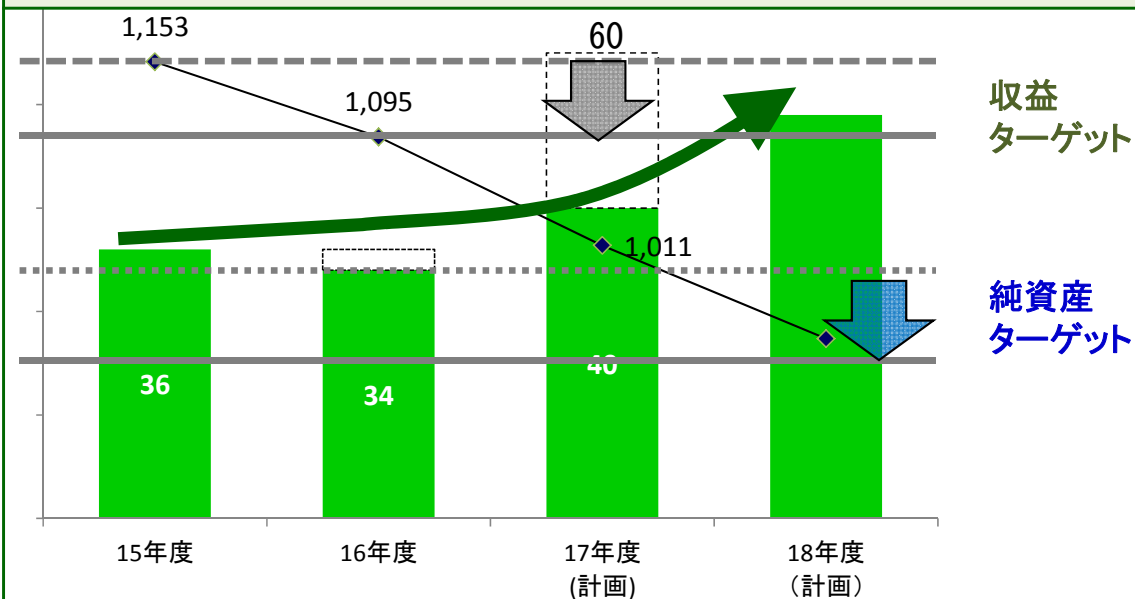
追加

レバレッジ引上げ

- 外資系半導体の計画比下振れ、大型投資案件の解消を主な要因として目標水準には至らず。
- ソリューションビジネスの事業拡大に向けての案件の萌芽、中国華南地区への戦略拠点確保等成果も確実に積み上がり。

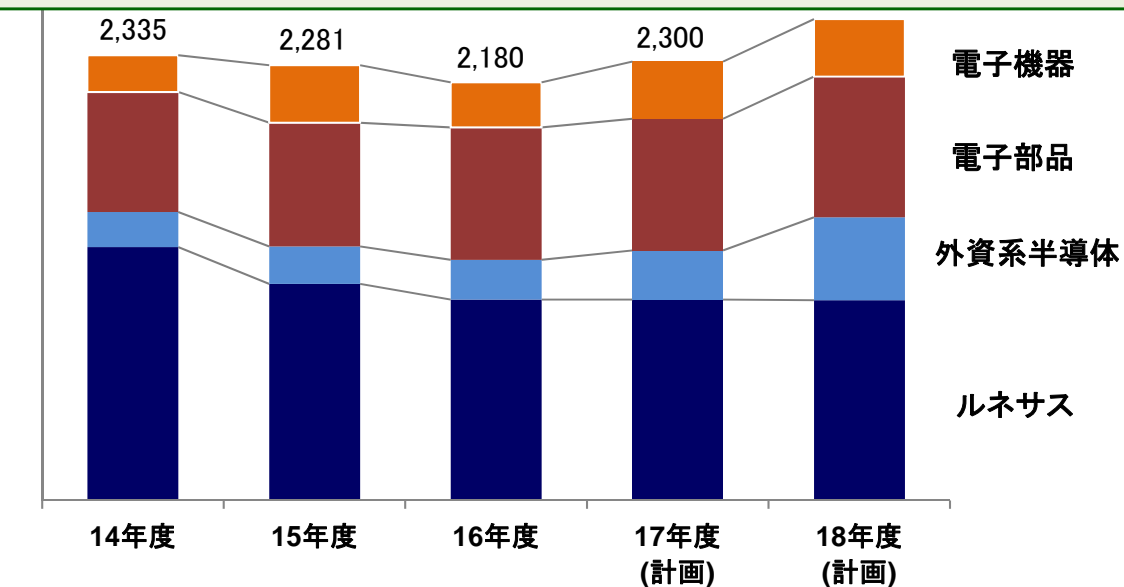
| セグメント | (単位:億円) | 14年度 | 17年度 (中計) | 17年度 (見込み) | 現状総括 |
|--------|---------|-------|--------------|---------------|---|
| 半導体 | 売上高 | 1,512 | 1,500 | 1,301 | ●外資系半導体の計画下振れ ●円高、震災による金額低下 ○華南地区への戦略拠点 |
| | 営業利益 | 34.8 | 51.0 | 33.5 | |
| 電子部品 | 売上高 | 619 | 700 | 684 | ○コンシューマー・車載中心に堅調な業績推移 |
| | 営業利益 | 16.1 | 20.3 | 20.0 | |
| 電子機器 | 売上高 | 193 | 300 | 300 | ●低売差大口取引の取り込み |
| | 営業利益 | 10.5 | 14.7 | 7.5 | |
| プロジェクト | 売上高 | 0.0 | 200 | 15.8 | ●大型投資案件の解消 ○商品販売力の強化 |
| | 営業利益 | 0.0 | 9.0 | - | |
| 合計 | 売上高 | 2,335 | 2,700 | 2,300 | |
| | 営業利益 | 59 | 95 | 56 | |

当期純利益/純資産推移



- トップラインの伸張は計画比弱含みであることから、ROE5%達成に向けてターゲットとする純資産規模を下方修正。
- 実現に向けて自社株買いプログラムの延長(FY18まで)、増額(4.5百万株)、増配(年間150円以上)を行う。
- 収益増加ピッチと純資産削減のピッチを勘案、ROE目標達成時期をFY18に1年後倒し。

事業別売上高推移



- 外資系半導体を主体とする成長シナリオは不変。
- 一層の経費削減と合わせ収益性の改善を進める。

資本効率改善に向けてのマイルストーン

| | 項目 | 施策 | FY18効果(FY16比) |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| 継続 | ソリューション事業 | パートナー企業連携 | 売上高当期利益率 +0.4% |
| 継続 | マルチベンダー化 | 外資系半導体・新規サプライヤー | |
| 継続 | グローバル化 | 中国ローカル、Edal連携 | |
| 追加 | 経費削減 | 販売管理費削減 | |
| 強化 | 成長投資 | 3年間50億円 | 総資産回転率+0.2倍 |
| 強化 | 自己株取得 | 4.5百万株、配当150円以上(2年間) 金庫株消却3百万株 | |
| 追加 | レバレッジ引上げ | 外部調達活用 | 財務レバレッジ+0.2倍 |

| | FY16 | | FY16 | FY17 | FY18 | FY18 |
|--------------|------|------------|--------|--------|--------|------|
| 売上高 当期利益率 | 1.5% | 営業利益率 | 2.1% | 2.4% | 2.8% | 2.0% |
| | | 販売管理比率 | 6.3% | 5.9% | 5.5% | |
| 総資産 回転率 | 1.4倍 | 現預金/総資産 | 24.0% | 18.0% | 13.0% | 1.6倍 |
| | | 売掛金回転期間(月) | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |
| 財務 レバレッジ | 1.4倍 | 自己資本比率 | 67.8% | 65.0% | 63.0% | 1.6倍 |
| | | 総還元性向 | 248.3% | 280.0% | 230.0% | |
| ROE | 3.0% | | | | | 5.0% |

| 施策の柱 | 実績 | 今後の打ち手 |
|---|---|---|
| <p>新たな ビジネスモデルの 創出</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 構築したビジネスモデルの事業化。 ■ NEDO委託事業の事業化への参画検討。 ■ 電池レス無線センサモジュールの構築。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 成長投資枠50億円(3年間)設定 ■ 外部パートナーとのアライアンス 推進 |
| <p>マルチベンダー化の 更なる推進</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 半導体メーカー再編を起点とする外資系半導体 ビジネスの国内商権拡大。 ■ 新規サプライヤー売上寄与。 ■ メリハリを付けた経営資源の投入。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 事業の柱候補への資源集中 ■ ノン・オーガニック的商権拡大 ■ 資金効率化 |
| <p>グローバル 対応強化による 海外ビジネスの 拡大</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ 香港Edal Electronics社の子会社化。 ■ 中国システムハウスとの協業推進。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Edal社との事業シナジー具体化 ■ 欧米地区商権拡大 ■ 中国パートナー企業との関係強化 |

| 施策の柱 | 実績 | 今後の打ち手 |
|--------------|---|---|
| 成長に向けた積極的な投資 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 注力事業への人的資源の先行投資(700百万円/年)(ソリューション事業、外資系半導体事業)。 ■ ベンチャーファンドへの投資(総額3億円)。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 人的先行投資継続 ■ 成長分野への戦略投資枠設定(3年間50億円) |
| 資本効率の向上 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 政策保有株削減。 ■ 自社株購入3.5百万株。 ■ 総配当140円/株継続 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 対象期間延長(FY18迄) ■ 購入枠増額(4.5百万株)(同上) ■ 総配当150円以上/株(同上) ■ 金庫株消却(3.0百万株) ■ 政策保有株削減継続 |
| 経費削減 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 物流を中心とする業務外注化 ■ 業務プロセス改革・業務システム投資 ■ 経常的コスト削減運動 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 販売管理費追加削減 |
| レバレッジ 引上げ | <ul style="list-style-type: none"> ■ 手元流動性資金による資本還元 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 外部調達資金による資本圧縮 ■ ファクタリング等による資産効率改善 |
| 経営の 質的強化 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 役員報酬体系、役員選任基準等制定。 コーポレートガバナンス・コードへの全項目準拠。 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 会長・社長体制移行 ■ CI推進 |

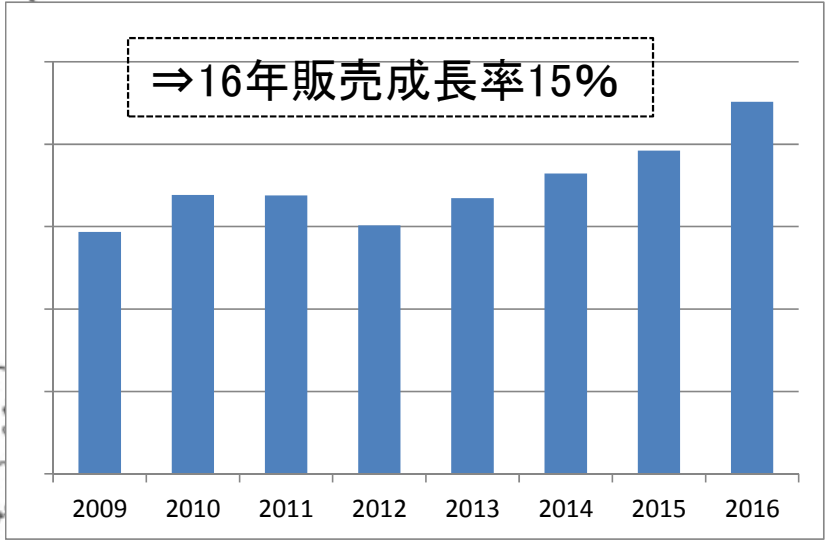
御参考

* Edal Electronics Co., Ltd

* ESEC2017

Edal Electronics Co., Ltd.への出資

| | | | |
|------|---|-----|-------------------|
| 設立 | 1987 | 従業員 | 82名(16/4末) |
| 出資比率 | 100% | 売上高 | US\$90.3Mil(FY16) |
| 取扱製品 | Monolithic Power Systems, Inc.(MPS) WeEn Semiconductors Co., Ltd, Nexperia, Power Integration, Inc. | | |
| 販売先 | 世界規模の生産台数有する華南地区液晶 TV部品・車載等地場メーカー(顧客数約 200社) | | |
| 事務所 | 香港・深圳・上海 | | |



ESEC 2017への出展(1/3)

■ 目的

- ・「既存ビジネス(商権ビジネス)からの脱却」に向けての当社取組みをアピール。
展示スペースを1.5倍に拡大。

◇ 開催期間:2017年5月10日~12日

◇ 展 示 物:

| | | | |
|-----------------|---|---------------|---|
| IoTソリューション |  | NFC機能付き温度ロガー |  |
| 電池レス無線モジュール |  | 鳥獣害対策システム |  |
| 車載向けAIソリューション |  | マルチカラーソリューション |  |
| 車載ネットワークソリューション |  | 環境浄化ソリューション |  |
| テレマティクスソリューション |  | 空中結像ディスプレイ |  |
| 非接触バイタルセンサ |  | 高速・高機能カメラシステム |  |
| 超小型光モジュール |  | | |



※ 展示ブース外観図

ESEC 2017への出展(2/3)

車載向けAIソリューション Automotive AI Solution



人工知能による
優れた認識技術を提供

- AIベースの高度な認識技術
- キャリブレーション・学習・検証まで高効率なツールキット
- ニューラルネットに最適なH/W IP
- 対象システムへのカスタマイズ対応

AI技術で
最適な
システム構築

システム構成

AIMOTIVE

aiDrive
レベル5の高度な自動運転AIベースの多機能SW一式を提供

aiKit
aiDrive開発に役立つ学習/検証 ツールを組み合わせたフレームワークを提供

aiWare
AIに最適化されたコストパフォーマンスに優れたH/Wアクセラレータを提供

aiDrive, aiKit, aiWare, AIMOTIVEは、日本、海外での各々の国に於ける登録商標及び特許です。

RYOSAN
<http://www.ryosan.co.jp>

株式会社 リョーサン
03-3862-2740

高ダイナミックレンジモードで移動体を鮮明に撮れるカメラシステム



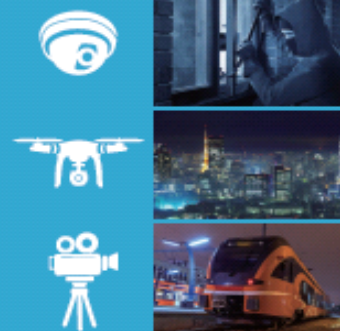
Brillnics H³DRTM 技術搭載
高感度・高ダイナミックレンジ
ブリルニクス製CMOSセンサ

- 単一と複数露光のハイブリッド(単一露光:86dB)
- 高感度
- 高速 120fps
- 12bit/16bitのデジタルアウト
- 多様なアプリケーションに対応

移動体を
高速・鮮明に
キャッチ

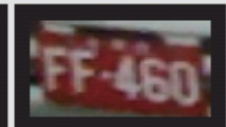
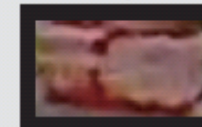
アプリケーション例

高ダイナミックレンジが必要な監視用監視カメラやドローン、ドライブレコーダー、電子ミラー、スポーツカム、ウェアラブルなど多様なアプリケーションに対応



他社

BRV0200 SEHDR



RYOSAN
<http://www.ryosan.co.jp>

株式会社 リョーサン
03-3862-2941

Si-Photonics技術を採用した 超小型光-電気変換モジュール



次世代高速通信を実現する 超小型光モジュール

- チップサイズ(5mm角)の超小型光モジュール
- 1チップで最大300Gbps伝送(25Gbps×12ch)
- 超低消費電力(5mW/Gbps)
- 受信側CDRなしMMFにて最大300m伝送が可能
- 85℃〜高温動作により小型・高密度実装が可能

次世代の
高速光通信技術

光I/Oコア

量子ドットレーザー
光ピン(I/O F)

フォトダイオード
TGV(電極 F)

装置間

基板間

LSI間

送信波形

受信波形

最大伝送距離 300m (MMF)

| 仕様 | |
|----------|-------------|
| 最大伝送距離 | 25Gbps×12ch |
| 消費電力 | 5mW/Gbps |
| 動作温度 | -40℃～85℃ |
| 光I/Oピン間隔 | ±10μm |

2017年度新技術開発競争大賞
PETRA
Copyright © PETRA, All rights reserved 2017

開発元: 株式会社 リョーサン
開発者: 株式会社 リョーサン
開発者: 株式会社 リョーサン

RYOSAN
<http://www.ryosan.co.jp>

株式会社 リョーサン
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
03-3862-2672

非接触バイタルセンサ Contactless Vital Sensor



非接触でバイタル検知を実現 カジュアルセンシングで日々の健康管理

- 無拘束でストレスフリーな健康管理が実現
- 温度・湿度・風・音などの影響を受けにくい
- 離れたところからバイタル検知
- 物陰でも電波が通過すれば検知可能

※ストレス値: 心拍変動率の算出結果 ※疲労度: 脳波エネルギー消費量を算出

非接触センサ+
独自アルゴリズム
で状態検知

多岐なアプリケーション活用例



人体表面の
微動を検知



RYOSAN
<http://www.ryosan.co.jp>

株式会社 リョーサン
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1
03-3862-2672